

# Produktinformation

## **FELDER-ISO-Tin<sup>®</sup> „HTL-Sn100Ni+, „HTL-Sn100Ni+-Refill“**

**Bleifreie Hochtemperatur Elektroniklote für die Anwendung in Selektiv- und Tauchlötanlagen bei hohen Löttemperaturen bis 500°C**

**Art.-Nr.: 5512961089 / 5512971089**

Die Angaben über unsere Produkte sind das Resultat langjähriger Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Ausführungen der mit unseren Produkten durchgeführten Arbeiten haben, beschränkt sich unsere Haftung auf die in unseren Verkaufsbedingungen bei Qualitätsmängeln vorgesehenen Ersatzleistungen.

Diese Produktinformationen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

## Anwendung

Bleifreie Weichlote für das Verzinnen von lackierten Kupferdrähten in Tauch- und Selektivlötanlagen bei hohen Löttemperaturen bis 500°C. (z.B. bei der Spulenfertigung oder im Transformatorenbau)

## Eigenschaften

Aufgrund des Ni-Anteiles von „HTL-Sn100Ni+“ wird die Kupferablegierung beim Lötprozess im Vergleich zu Nickelfreien Loten reduziert. Dies wurde durch umfangreiche Untersuchungen eindeutig belegt. Dadurch wird auch die Reduzierung des Drahtquerschnittes beim Lötvorgang verringert. Dieses Lot wird ohne Phosphor gefertigt um eine Ausfällung von Phosphor bei hohen Löttemperaturen zu vermeiden.

FELDER ISO-Tin®	Legierung	Schmelzpunkt	Löttemperatur	FELDER Artikel-Nr.:
HTL-Sn100Ni+	Sn99,2Cu0,7AgNiGe	227°C	300-500 °C	5512961089
HTL-Sn100Ni+-Refill	Sn99,9AgNiGe	232°C	300-500 °C	5512971089
Weitere Legierungen sind auf Kundenwunsch lieferbar.				

Das HTL-Sn100Ni+-Refill wird zum Nachfüllen von Tauchlötbadern eingesetzt um die Kupferverunreinigung durch den Ablegierungsprozess zu kompensieren.

## Lieferformen

Gepresste Pellets, Kartons á 20 kg

Auch als Massivdraht auf Spulen und als 400g-Stangen lieferbar.

## Hinweise

Andere Legierungen sind in unserem Standardlieferprogramm enthalten.